

概 要

本概要旨在為閣下提供本文件所載資料的概覽，其須與載於本文件其他部分的更詳盡資料及財務資料一併閱讀，以確保其完整性。由於僅為概要，故並不包含對閣下而言可能屬重要的全部資料，務請閣下於作出[編纂]決定前細閱整份文件。任何[編纂]均涉及風險。與投資[編纂]有關的部分特定風險載於本文件「風險因素」一節。閣下在決定[編纂][編纂]前務請細閱該節。

我們的使命

專註用於半導體及印刷電路板（「PCB」）製造的等離子處理設備的研發及製造創新，從而帶動中國高科技電子產業國內產業鏈的自主發展。

我們是誰

我們是在中國享有重要市場地位的等離子處理設備製造商，專業從事PCB及半導體製造等高科技電子領域使用的等離子處理設備的研發、製造與銷售，業務遍佈中國內地、東南亞、北美及歐洲等地。根據弗若斯特沙利文報告，按2023年至2025年各年於中國產生的收入計，我們在中國PCB等離子除膠渣設備市場排名前三。根據同一資料來源，按2025年於中國產生的收入計，我們在中國PCB等離子處理設備的市場份額約為3.6%。憑借我們在等離子處理技術方面的專業知識，我們戰略性地集中資源及開發力量，擴大我們在用於半導體製造領域的等離子處理設備的能力及市場佔有率。

我們的設備主要包括(i)廣泛應用於PCB製造、消費電子及其他行業的等離子除膠渣設備，以及用於PCB製造的輔助設備；(ii)半導體干法去膠設備及干法刻蝕設備，以及用於半導體封裝的等離子除浮渣設備；及(iii)用於等離子除膠渣設備的上下料設備。我們亦為客戶提供用於等離子處理設備的零部件及配件，以及維修及維護服務。我們提供具備定製功能的設備，與客戶生產流程深度契合，以滿足下游客戶的廣泛應用需求。

- 我們一直致力於研發應用於PCB及其他行業的產品，並已開發出全系列等離子除膠渣設備，旨在強化生產與維護中的表面處理工藝。我們的設備可以有效去除產品表面污染物和氧化層，提高焊接和粘合性能，這對提升PCB的性能及可靠性至關重要。
- 我們亦致力於研發及製造用於半導體封裝的等離子除浮渣設備、整平設備及撕膜設備。基於對半導體製造領域高精度加工設備需求增長的洞察，我們於2023年3月

概 要

將產品線擴展至干法去膠設備及干法刻蝕設備。這些產品依託我們近20年的等離子處理技術積澱，可滿足先進半導體製造工藝的嚴苛要求。

我們以干法去膠設備及干法刻蝕設備為代表的用於半導體製造工藝的產品能有效滿足先進半導體製造的要求，在準確度、可靠性上均有著優良表現。刻蝕是半導體圖案化過程的核心工藝，干法刻蝕設備主要用於去除特定區域的材料來形成微小的結構圖案。干法刻蝕設備被稱為半導體製造核心設備之一，價值量高，市場規模可觀。除干法刻蝕設備外，干法去膠設備亦是半導體刻蝕環節的重要設備。

於往績記錄期間，我們的收入主要來自(i)銷售應用於PCB製造及其他行業的等離子除膠渣設備，主要包括等離子除膠渣設備，以及用於PCB製造的輔助設備；(ii)銷售應用於半導體製造的等離子處理設備，主要包括干法去膠設備及干法刻蝕設備，以及用於半導體封裝的等離子除浮渣設備；(iii)銷售用於等離子除膠渣設備的上下料設備；(iv)銷售用於等離子處理設備的零部件及配件；及(v)提供等離子處理設備的維修及維護服務。

我們的競爭優勢

我們認為，以下競爭優勢鑄就了我們的成功，使我們從競爭對手中脫穎而出並贏得信賴：

- 我們是領先的等離子處理設備製造商，並在中國先進半導體處理設備領域快速發展
- 關鍵技術領先，確保產品持續滿足客戶需求並在行業中普遍應用
- 持續擴展且性能強大的產品組合
- 差異化客戶觸達及穩定客戶合作關係
- 戰略性佈局海外市場，賦能中國品牌走向世界
- 富有遠見並具開拓精神的管理及人才團隊

詳情請參閱「業務 — 我們的競爭優勢」。

概 要

我們的發展戰略

我們致力通過實施以下戰略，以期實現我們的業務目標及使命：

- 加強半導體製造行業的業務佈局
- 持續投資技術創新
- 不斷拓展產品矩陣並提升產品性能
- 強化我們的產能保障及生產工藝
- 加強對半導體領域海外銷售業務機會的探索，實現全球擴張
- 尋求戰略投資及收購機會

請參閱「業務 — 我們的發展戰略」。

我們的產品和服務

我們是在中國享有重要市場地位的等離子處理設備製造商，專業從事等離子處理設備的研發、生產製造與銷售。我們為PCB及半導體製造等高科技電子領域的客戶提供全面的等離子處理設備。此外，我們還提供與等離子處理設備相關的各種零部件及配件以及維修及維護服務，以滿足客戶的多樣化需求。

等離子是由離子和自由電子組成的電離氣體的一種狀態，有著獨特的物理和化學性質。有關性質使等離子能有效與各種材料相互作用，成為表面處理應用中的一種有價值的工具。利用可生成氣體混合物、壓力和功率等參數的高精度設備，精確指定和調整等離子與表面材料相互作用的影響，實現預期的成果。因此，待處理的材料將被衝擊，並與混合氣體一併排出。常見的等離子處理包括刻蝕、表面活化以及塗層，其廣泛應用於各種工業領域。

憑藉我們在等離子處理技術方面的專業能力，我們提供用於PCB及半導體製造以及消費電子等其他應用領域的多樣化且先進的等離子處理設備組合，以滿足下游客戶對高端處理環節的高技術、高效率需求。我們的資深技術人員在深入了解客戶對處理環節設備的需求後，基於傳統處理技術和設備進行改良，並精心設計和研發高性能的處理設備。我們的

概 要

生產基地既能生產滿足客戶非標準化需求的定製設備，也能製造標準化的先進工藝設備，例如干法去膠設備及干法刻蝕設備，以滿足下游客戶的大量採購需求。此外，我們可根據客戶需求提供設備維修及維護服務。除了就所售產品在保修期內提供安裝、定期檢查及維護服務外，我們還為保修期到期後的產品提供收費的維修和維護服務。鑒於我們的技術和生產能力，應客戶要求，我們還被客戶聘請為其從同行企業購買的應用於PCB產品的等離子處理設備提供維修和維護服務。我們在等離子處理設備方面的廣泛產品覆蓋，加上我們提供靈活服務的能力，產生了一種協同效應，進而增強了我們在行業生態系統中的影響力。

用於PCB製造及其他應用領域的等離子除膠渣設備

我們針對PCB製造及消費電子行業設計的產品涵蓋一系列等離子處理設備，主要用於PCB及消費電子生產製造與產後維護過程中的清潔及其他必要工序，能有效去除表面的污染物與氧化層，提升錫焊焊接和壓焊性能。

我們還提供用於PCB製造從初始表面準備到最終檢測過程的輔助設備。該等輔助設備乃向第三方供應商採購，並僅偶爾提供予我們的客戶，佔我們收入的比例相對較小。

用於半導體製造的設備

我們製造並提供用於半導體封裝的等離子處理設備，包括半導體除浮渣設備、整平設備及撕膜設備。基於對半導體製造領域高精度加工設備需求增長的洞察，我們自2023年3月將產品線擴展至干法去膠設備及干法刻蝕設備。

用於等離子除膠渣設備的上下料設備

上下料設備是一款專為等離子除膠渣設備設計的PCB板全自動上下料設備，可促進前後工序之間的工作流連接。作為等離子除膠渣設備應用場景中上下游生產工序間的智能樞紐，上下料設備具備高精度、高效率的PCB板自動化搬運能力。我們的上下料設備在配置上具備靈活性，最多可同時與四台等離子除膠渣設備協同工作。這大幅優化了多設備協同的生產效率，最大限度減少人工操作，並提高了操作效率。

零部件及配件

於往績記錄期間，我們在生產基地進行生產，並向客戶銷售設備所用的零部件及配件，作為設備銷售的補充。我們生產及銷售的零部件及配件主要包括石英玻璃、真空泵、電機組件、中頻電源、柔性電路夾具、天線組件、微波匹配器及氧化鋁管。

概 要

維修及維護服務

於往績記錄期間，我們向客戶收取服務費以就超過保修期的產品提供維修及維護服務，且為認可我們的技術及生產能力，應客戶要求，我們亦獲委聘為彼等從同行企業購買的等離子處理設備提供售後服務。

詳情請參閱「業務 — 我們的產品及服務」。

研發

我們所有設備中使用的核心技術均由我們的內部研發團隊開發。我們已成功開發並推出多款以等離子處理技術為特色的設備，應用於PCB製造、半導體、消費電子等行業。我們還創新開發了全自動上下料設備，與等離子處理設備配合使用，以提高客戶生產過程中的運營效率。我們擬根據客戶需求及市場趨勢，通過加強新產品的研發及改進現有產品，擴大及改善我們的產品組合。

詳情請參閱「業務 — 研發」。

生產

我們內部開發了以商業規模生產產品所需的製造工藝。我們的製造團隊由我們的首席開發官徐元鋒領導，彼於等離子處理行業擁有約20年經驗。截至2025年12月31日，我們的生產部門有84名人員。我們向生產部門人員提供培訓，以確保彼等具備相關生產過程所需的技能及技術，並遵守我們的質量控制要求以及適用法律及法規。

我們的生產部門由三個專業部門組成：機械加工部、電氣控制部及裝配部。機械加工部將採購的材料加工成我們產品所需的零部件。電氣控制部根據我們的設計師提供的原理圖組裝控制面板。最後，裝配部將所有零部件及控制面板集成在一起，完成最終產品。

於往績記錄期間，我們擁有一個生產基地，即珠海紅旗生產基地。詳情請參閱「業務 — 生產」。

銷售及營銷

基於我們產品的強大競爭力及我們在等離子處理技術領域多年的專業知識，我們的產品銷往中國內地、東南亞、北美及歐洲。在中國，我們的產品銷往17個省、市、自治區及特別行政區。

於往績記錄期間，我們的產品於中國主要透過直銷銷售。為擴大我們產品的地區覆蓋、消費者覆蓋，我們在海外市場利用經銷網絡補充直銷。於2023年、2024年及2025年，直銷

概 要

收入分別為人民幣104.4百萬元、人民幣129.0百萬元及人民幣156.8百萬元，佔同年總收入的75.4%、86.1%及89.1%。於2023年、2024年及2025年，我們分別擁有129名、132名及145名直銷客戶，該等主要為PCB客戶。

於往績記錄期間，我們與海外及國內市場的經銷商訂立經銷協議。根據弗若斯特沙利文的資料，我們採用經銷商模式符合行業常規。於2023年、2024年及2025年，我們分別擁有五家、五家及五家經銷商，並與其訂立經銷協議。於2023年、2024年及2025年，來自經銷商的收入分別為人民幣34.1百萬元、人民幣20.8百萬元及人民幣19.2百萬元，佔同年總收入的24.6%、13.9%及10.9%。

詳情請參閱「業務 — 銷售、營銷及客戶 — 銷售渠道及客戶」。

我們的客戶

我們向各行各業的客戶提供產品，主要包括PCB、半導體及消費電子產品。於2023年、2024年及2025年，我們向中國內地及海外(主要包括東南亞、北美及歐洲)分別約134名、137名及150名客戶提供我們的產品及服務。

於2023年、2024年及2025年，來自我們最大客戶的收入分別佔我們於該等年度總收入的20.1%、19.0%及24.6%。於2023年、2024年及2025年，來自我們五大客戶的收入分別佔我們同年總收入的60.9%、51.5%及62.7%。

詳情請參閱「業務 — 銷售、營銷及客戶 — 五大客戶」。

我們的供應商

我們向供應商採購用於製造產品的各種材料，包括鋁材、真空泵及射頻發生器等。我們的採購計劃乃根據存貨水平及市場供應情況而制定。於2023年、2024年及2025年，每年向我們五大供應商的採購額分別佔我們於該等年度總採購額的25.9%、30.7%及28.2%。於2023年、2024年及2025年，向我們最大供應商的採購額分別佔我們於該等年度總採購額的9.6%、10.7%及10.6%。

詳情請參閱「業務 — 採購和供應鏈管理」。

競爭格局

由於技術壁壘較高(除本文件所披露者外)，中國等離子處理設備市場的參與者數量相對有限，導致整體市場競爭集中度較高。根據弗若斯特沙利文的資料，按2025年的收入計算，前五大市場參與者佔中國市場份額的72.3%。中國的市場參與者可分為國際製造商和國內製造商。得益於在技術研發和產品佈局上的先發優勢，國際製造商長期以來在中國等離子處

概 要

理設備市場佔據主導地位。然而，隨著國內製造商技術的快速進步和新產品的不斷推出，少數國內企業逐漸獲得了更多的市場份額。中國的PCB等離子除膠渣設備行業也有類似的高進入壁壘。然而，與更廣泛的等離子體處理設備市場相比，中國PCB等離子除膠渣設備市場相對分散——根據弗若斯特沙利文的資料，按2025年的收入計算，前三名參與者僅佔13.0%的市場份額。根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年至2025年各年於中國產生的收入計算，我們在中國PCB等離子除膠渣設備市場中排名前三。根據同一資料來源，按2025年於中國產生的收入計算，我們在中國PCB等離子處理設備市場的市場份額約為3.6%。

有關我們產品主要競爭對手的更多詳情，請參閱本文件「行業概覽」一節。

風險管理及內部控制

我們已採用一套全面的風險管理政策，其中載列風險管理框架，以持續識別、評估、評價及監察與我們的戰略目標相關的主要風險。我們的高級管理層和董事會監督我們風險管理政策的實施。管理層識別的風險將按可能性及影響進行分析，並將由本集團妥善跟進、減輕及糾正，以及向高級管理層報告。

我們的董事會負責建立並確保有效的內部控制，以始終保護我們股東的投資。我們的內部控制政策制定了一個框架，以持續識別、評估、評價及監察與我們的戰略目標相關的主要風險。

更多詳細討論請參閱「業務 — 風險管理及內部控制」。

知識產權

我們建立了全面的知識產權組合，以保護我們的技術和發明，並確保我們未來的成功。截至2025年12月31日，我們在中國內地擁有27項已批准專利，包括16項發明專利和10項實用新型專利，以及一項外觀設計專利，並在台灣擁有五項已批准專利。截至2025年12月31日，我們在中國內地擁有八項註冊商標，香港擁有三項註冊商標。詳情請參閱「業務 — 知識產權」。

歷史財務資料概要

下表概述我們於往績記錄期間的綜合財務業績，並應與本文件「財務資料」一節及本文件附錄一所載會計師報告一併閱讀。

概 要

綜合損益及其他全面收入表概要

下表載列我們於所示期間的綜合損益及其他全面收入表概要。

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
收入	138,531	149,710	176,041
銷售成本	(64,699)	(74,919)	(77,543)
毛利	73,832	74,791	98,498
其他收入	698	579	3,694
金融資產及其他項目的減值虧損 (包括減值虧損的撥回或減值收益)	(12)	(333)	(2,652)
其他收益及虧損	(66)	675	(638)
[編纂]	—	—	[編纂]
經銷及銷售開支	(8,977)	(8,746)	(10,341)
行政開支	(13,390)	(11,743)	(18,779)
研發開支	(10,070)	(10,453)	(11,983)
其他開支	(10)	(1)	(566)
財務成本	(258)	(245)	(640)
除稅前溢利	41,747	44,524	41,949
所得稅開支	(4,967)	(5,281)	(4,621)
年內溢利	36,780	39,243	37,328
其他全面開支			
其後可能被重新分類為損益的項目：			
海外經營換算匯兌差額	—	—	(26)
年內全面開支收入總額	36,780	39,243	37,302

收入

於往績記錄期間，我們的收入主要來自(i)銷售應用於PCB製造及其他行業的等離子除膠渣設備及輔助設備；(ii)銷售應用於半導體製造的等離子處理設備，主要包括干法去膠設備及干法刻蝕設備，以及用於半導體封裝的等離子除浮渣設備；(iii)銷售用於等離子除膠渣設備的上下料設備，(iv)銷售等離子處理設備的零部件及配件，及(v)提供等離子處理設備的維修及維護服務。

概 要

按業務分部劃分的收入

下表載列於所示年度我們按業務分部劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
設備						
用於PCB製造及其他應用領域.....	86,825	62.7	79,058	52.8	103,819	59.0
—用於PCB製造的等離子除膠渣設備.....	76,712	55.4	59,534	39.8	76,637	43.5
—用於其他應用領域的 等離子除膠渣設備 ⁽¹⁾	10,113	7.3	19,524	13.0	23,218	13.2
—用於PCB製造的輔助設備.....	—	—	—	—	3,964	2.3
用於半導體製造.....	11,779	8.5	35,569	23.8	19,232	11.0
—用於半導體封裝的設備.....	11,779	8.5	18,851	12.6	15,777	9.0
—干法去膠設備及干法刻蝕設備.....	—	—	16,718	11.2	3,455	2.0
用於等離子除膠渣設備的上下料設備.....	16,424	11.8	2,890	1.9	7,082	4.0
小計.....	115,028	83.0	117,517	78.5	130,133	74.0
零部件及配件.....	13,290	9.6	20,290	13.6	28,794	16.3
維修及維護服務.....	10,213	7.4	11,903	7.9	17,114	9.7
總計.....	138,531	100.0	149,710	100.0	176,041	100.0

附註：

(1) 主要包括消費電子、汽車電子零件及顯示面板電子元件。

概 要

按地理位置劃分的收入

於往績記錄期間，我們的大部分收入來自中國內地。下表載列於所示年度我們按地理位置劃分的收入明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
中國內地	95,804	69.2	112,385	75.1	103,050	58.5
泰國	—	—	7,624	5.1	23,403	13.3
台灣	2,250	1.6	4,643	3.1	18,175	10.3
美國	27,803	20.1	12,561	8.4	11,976	6.8
其他國家及地區 ⁽¹⁾	12,674	9.1	12,497	8.3	19,437	11.0
總計	<u>138,531</u>	<u>100.0</u>	<u>149,710</u>	<u>100.0</u>	<u>176,041</u>	<u>100.0</u>

附註：

(1) 主要包括馬來西亞、越南、荷蘭及日本。

毛利及毛利率

下表載列於所示年度我們按業務分部劃分的毛利及毛利率明細：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
設備						
用於PCB製造及其他應用領域	46,995	54.1	44,268	56.0	57,141	55.0
用於半導體製造	4,749	40.3	8,271	23.3	7,814	40.6
用於等離子除膠渣設備的上下料設備	7,777	47.4	1,162	40.2	3,037	42.9
零部件及配件	9,344	70.3	14,787	72.9	20,585	71.5
維修及維護服務	4,967	48.6	6,303	53.0	9,921	58.0
總計	<u>73,832</u>	<u>53.3</u>	<u>74,791</u>	<u>50.0</u>	<u>98,498</u>	<u>56.0</u>

概 要

綜合財務狀況表概要

下表載列我們截至所示日期的綜合財務狀況表的節選資料，該等資料摘錄自本文件附錄一所載我們的經審核財務報表：

	截至12月31日		
	2023年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
非流動資產總值.....	17,234	28,651	58,162
流動資產總額.....	147,946	184,600	261,180
流動負債總值.....	39,792	48,366	64,928
流動資產淨值.....	108,154	136,234	196,252
總資產減流動負債.....	125,388	164,885	254,414
非流動負債總額.....	4,467	3,013	3,679
資產淨值.....	120,921	161,872	250,735
權益總額.....	<u>120,921</u>	<u>161,872</u>	<u>250,735</u>

綜合現金流量表概要

下表載列於所示年度我們的綜合現金流量表概要：

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
營運資金變動前的經營現金流量.....	47,085	50,716	52,109
營運資金變動.....	(31,825)	(47,503)	23,084
經營所得現金.....	15,260	3,213	75,193
已收利息.....	116	135	215
已付所得稅.....	(4,892)	(472)	(8,987)
經營活動所得現金淨額.....	<u>10,484</u>	<u>2,876</u>	<u>66,421</u>
投資活動所用現金淨額.....	(380)	(14,372)	(29,151)
融資活動(所用)現金淨額.....	(1,613)	8,672	55,992
現金及現金等價物增加/(減少)淨額.....	8,491	(2,824)	93,262
年初現金及現金等價物.....	11,260	19,791	17,011
匯率變動的影響.....	40	44	(191)
年末現金及現金等價物.....	<u>19,791</u>	<u>17,011</u>	<u>110,082</u>

概 要

主要財務比率

下表載列我們截至所示日期／年度的主要財務比率：

	截至12月31日／截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
毛利率 ⁽¹⁾	53.3%	50.0%	56.0%
淨利率 ⁽²⁾	26.6%	26.2%	21.2%
流動比率 ⁽³⁾	3.7	3.8	4.0
速動比率 ⁽⁴⁾	2.2	2.8	3.1

附註：

- (1) 毛利率按相應年度毛利除以收入再乘以100%計算。
- (2) 淨利率乃按相應年度的年內利潤除以收入再乘以100%計算。
- (3) 流動比率按截至相關日期流動資產總值除以流動負債總額計算。
- (4) 速動比率按截至相關日期流動資產總值減存貨再除以流動負債總額計算。

風險因素

投資我們的股份存在若干風險。有關風險因素的詳細討論載於「風險因素」一節。關鍵風險因素概述如下。以下任何發展可能對我們的業務、財務狀況、經營業績及前景造成重大不利影響：

- 我們的過往業績可能無法反映我們的未來表現，我們可能無法成功擴大業務或管理增長。
- 無法開發並推出新產品，可能對我們的競爭力、表現及未來增長前景造成不利影響。
- 我們依賴使用我們產品的終端市場的增長。這些終端市場的任何增長放緩都可能對我們的業務、財務狀況及經營業績產生不利影響。
- 我們於競爭激烈的行業經營。倘我們無法有效競爭，我們的業務、經營業績及未來前景將受到損害。

詳情請參閱「風險因素」。

合規及法律訴訟

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無發生任何董事認為個別或整體可能對我們的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響的不合規事件。更多詳細討論請參閱「業務 — 合規及法律訴訟」。

概 要

我們的控股股東

截至最後實際可行日期，趙先生可透過(i)其直接持有的35,709,500股股份；(ii)慕風科技持有的400,000股股份；(iii)德承記持有的2,796,000股股份行使本公司約78.79%的投票權。慕風科技分別由趙先生、羅女士(趙先生的配偶)及趙女士(趙先生之女)擁有約60%、20%及20%。趙先生、羅女士及趙女士透過共同投資工具及彼等之間的配偶關係持有權益而被推定為一組控股股東。德承記的普通合夥人為趙先生。緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使且未根據[編纂]購股權計劃發行股份)，趙先生將直接及間接有權行使本公司約[編纂]%的投票權。因此，根據上市規則，趙先生、羅女士、趙女士、慕風科技及德承記於[編纂]後將被視為一組控股股東。

請參閱本文件「與控股股東的關係」。

[編纂]投資

透過認購本公司增加的註冊資本及透過當時股東轉讓，本公司獲得[編纂]投資者的兩輪投資。有關詳情請參閱本文件「歷史、發展及公司架構—[編纂]投資」。

[編纂]統計數據

	按每股[編纂] [編纂][編纂]港元計算	按每股[編纂] [編纂][編纂]港元計算
我們股份的[編纂] ⁽¹⁾	[編纂]百萬港元	[編纂]百萬港元
[編纂]經調整每股[編纂] 有形資產淨值 ⁽²⁾	[編纂]港元	[編纂]港元

附註：

- (1) [編纂]乃按緊隨[編纂]完成後預計已發行[編纂]股股份計算(假設[編纂]未獲行使且未根據[編纂]購股權計劃發行股份)。
- (2) 截至2025年12月31日的[編纂]經調整每股[編纂]有形資產淨值乃經本文件「附錄二—[編纂]財務資料」一節所述調整後得出。

[編纂]

假設[編纂]為每股H股[編纂]港元(即本文件所述[編纂]範圍的中位數)，經扣除我們就[編纂]應付的[編纂]費用、佣金及估計開支後，並假設[編纂]未獲行使，我們預計[編纂][編纂]將約為[編纂]百萬港元。

概 要

我們擬將[編纂][編纂]用於以下用途，概約金額如下：

- [編纂]約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於在珠海新總部建設新生產基地，該基地將取代我們現有的生產設施，並作為我們的辦公場所。
- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於投資前瞻技術的研發。
- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於設立海外辦事處。
- 約[編纂]%或[編纂]百萬港元將用於一般公司及營運資金用途。

詳情請參閱「未來計劃及[編纂]」。

股息

我們於2025年宣派股息人民幣50.0百萬元，派息率為64.7%。我們於2023年及2024年並未宣派股息。派息率乃按我們於相關年度宣派的股息除以相關年度本公司股東應佔可供分派淨溢利的年初結餘計算。截至2025年12月31日，我們已悉數支付截至2025年12月31日止財政年度宣派的股息。請參閱本文件附錄一會計師報告附註34。

未來宣派及派付任何股息將由董事會決定，並將取決於多項因素，包括我們的財務表現及業務運營、資本要求及合約限制。股東可於股東會上批准任何股息宣派。除非從我們的合法可供分派溢利及儲備中撥款，否則不得宣派或支付股息。誠如我們的中國法律顧問所確認，根據中國法律，我們所賺取的任何未來淨溢利將須首先用於彌補我們的歷史累計虧損，其後我們將有義務將我們淨溢利的至少10%分配至我們的法定公積金，直至公積金的累計金額達到我們註冊資本的50%以上。因此，我們將僅能在(i)我們過往財政年度的所有歷史累計虧損已獲彌補；及(ii)我們已分配足夠淨溢利至我們的法定公積金(如上文所述)後宣派股息。

詳情請參閱「財務資料—股息」。

[編纂]

概 要

[編纂]

[編纂]

我們的[編纂]指就[編纂]及[編纂]產生的專業費用、[編纂]及其他費用。假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元，即指示性[編纂]範圍的中位數，且[編纂]未獲行使，我們估計我們的[編纂]將約為人民幣[編纂]百萬元（[編纂]百萬港元）。[編纂]包括(i)[編纂]相關開支（包括[編纂]）約人民幣[編纂]百萬元（[編纂]百萬港元），及(ii)[編纂]相關開支約人民幣[編纂]百萬元（[編纂]百萬港元），包括(a)保薦人費用約人民幣[編纂]百萬元（[編纂]百萬港元）；(b)法律顧問及申報會計師的費用及開支約人民幣[編纂]百萬元（[編纂]百萬港元），及(c)其他費用及開支約人民幣[編纂]百萬元（[編纂]百萬港元）。於往績記錄期間，2025年的[編纂]人民幣[編纂]百萬元自損益扣除。我們預期於[編纂]完成後產生額外[編纂]約人民幣[編纂]百萬元，預期將從權益中扣除。上述[編纂]為截至最後實際可行日期的最佳估計（僅供參考），實際金額可能與此估計有所不同。

於一般業務營運過程中，我們可能涉及合約糾紛、訴訟或其他法律程序。請參閱「風險因素—與行業及業務相關的風險—我們面臨與僱員、競爭對手、業務夥伴或其他方出現訴訟和糾紛有關的風險，這可能對我們的業務、財務狀況、經營業績及前景產生不利影響。」截至最後實際可行日期，本公司、任何我們的附屬公司或任何董事概無涉及任何可能對本集團財務狀況或經營業績造成重大不利影響的重大訴訟、仲裁或申索。

近期發展及無重大不利變動

於往績記錄期後及直至最後實際可行日期，除本文件所披露者外，我們的業務保持穩定。董事認為，自2025年12月31日（即本文件附錄一會計師報告所載綜合財務報表的最新結算日）起，我們的業務、財務狀況及經營業績並無重大不利變動。